Dell EMC PowerEdge R740xd
Technical Specifications
メモ、注意、警告

メモ: 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。
1 PowerEdge R740xd システムの概要 ................................................................. 4

2 技術仕様 ........................................................................................................... 5
   システムの寸法.................................................................................................. 5
   シャーシの重量................................................................................................. 6
   プロセッサの仕様.............................................................................................. 6
   対応オペレーティングシステム......................................................................... 7
   PSU の仕様......................................................................................................... 7
   システムバッテリーの仕様............................................................................... 8
   拡張バスの仕様............................................................................................... 8
   メモリの仕様.................................................................................................. 10
   ストレージコントローラの仕様...................................................................... 10
   ドライブの仕様.............................................................................................. 11
   ドライブ.......................................................................................................... 11
   ポートおよびコネクタの仕様.......................................................................... 12
   USB ポート...................................................................................................... 12
   NIC ポート...................................................................................................... 12
   VGA ポート..................................................................................................... 12
   シリアルコネクタ............................................................................................ 12
   内蔵デュアル SD モジュールまたは vFlash カード...................................... 12
   ビデオの仕様................................................................................................. 12
   環境仕様.......................................................................................................... 13
   標準動作温度.................................................................................................. 14
   動作時の拡張温度.......................................................................................... 14
   粒子状およびガス状汚染物質の仕様................................................................. 16

3 マニュアルリソース ......................................................................................... 17

4 困ったときは ..................................................................................................... 19
   Dell EMC へのお問い合わせ............................................................................. 19
   マニュアルのフィードバック........................................................................ 19
   QRL によるシステム情報へのアクセス.......................................................... 19
   PowerEdge R740 システム用 Quick Resource Locator.............................. 20
   SupportAssist による自動サポートの利用...................................................... 20
   リサイクルまたはサービス終了の情報............................................................ 20
PowerEdge R740xd システムの概要

PowerEdge R740xd は最大で以下の内容をサポートする 2U ラック サーバです。

- インテル Xeon スケーラブル プロセッサー 2 基
- DIMM スロット 24 個
- AC または DC 電源装置ユニット 2 台
- 32 SAS、SATA、Nearline SAS ハード ドライブまたは SSD、最大 24 NVMe ドライブ。サポートされているドライブの詳細については、「仕様詳細」の項を参照してください。

メモ: SAS、SATA ハード ドライブ、NVMe および SSD のすべてのインスタンスは、別段の指定がない限り、この文書内ではドライブと呼ばれます。
技術仕様

本項では、お使いのシステムの技術仕様と環境仕様の概要を示します。

トピック:

- システムの寸法
- シャーシの重量
- プロセッサの仕様
- 対応オペレーティングシステム
- PSU の仕様
- システムバッテリーの仕様
- 拡張バスの仕様
- メモリの仕様
- ストレージコントローラの仕様
- ドライブの仕様
- ポートおよびコネクタの仕様
- ビデオの仕様
- 環境仕様

システムの寸法

本項では、システムの物理的寸法について説明します。
図1. PowerEdge R740xd システムのシステム寸法

表1. 寸法

<table>
<thead>
<tr>
<th>システム</th>
<th>Xa</th>
<th>Xb</th>
<th>Za (ベゼルを含む)</th>
<th>Za (ベゼルを含まない)</th>
<th>Zb</th>
<th>Zc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PowerEdge R740xd</td>
<td>482.0 mm (18.98インチ)</td>
<td>434.0 mm (17.09インチ)</td>
<td>86.8 mm (3.42インチ)</td>
<td>35.84 mm (1.41インチ)</td>
<td>22.0 mm (0.87インチ)</td>
<td>678.8 mm (26.72インチ)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

シャーシの重量

表2. シャーシの重量

<table>
<thead>
<tr>
<th>システム</th>
<th>最大重量（すべてのドライブ/SSDを含む）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.5インチドライブシステム</td>
<td>28.1 kg (61.95ポンド)</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5インチドライブシステム</td>
<td>33.1 kg (72.91ポンド)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

プロセッサの仕様

PowerEdge R740xd システムは、最大 2 基のインテル Xeon プロセッサ スケーラブル ファミリーのプロセッサー（プロセッサーごとに最大 28 コア）をサポートします。


対応オペレーティングシステム

PowerEdge R740xd は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。
Canonical Ubuntu LTS
Citrix XenServer
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

特定のバージョンおよび追加情報については、www.dell.com/support/home/Drivers/SupportedOS/poweredge-r740xd にアクセスしてください。

PSU の仕様

PowerEdge R740xd システムは、最大 2 台の AC または DC 電源装置ユニット（PSU）をサポートします。

表 3. PSU の仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>PSU</th>
<th>クラス</th>
<th>熱消費（最大）</th>
<th>周波数</th>
<th>電圧</th>
<th>高圧線 200V</th>
<th>低圧線 100 ~ 140V</th>
<th>DC</th>
<th>現在</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>495 W AC</td>
<td>Platinum</td>
<td>1908 BTU/時</td>
<td>50/60Hz</td>
<td>100 ~ 240 V AC、オートレンジ</td>
<td>495 W</td>
<td>495 W</td>
<td>該当なし</td>
<td>6.5 A ~ 3 A</td>
</tr>
<tr>
<td>750 W AC</td>
<td>Platinum</td>
<td>2891 BTU/時</td>
<td>50/60Hz</td>
<td>100 ~ 240 V AC、オートレンジ</td>
<td>750 W</td>
<td>750 W</td>
<td>該当なし</td>
<td>10 A ~ 5 A</td>
</tr>
<tr>
<td>750 W AC</td>
<td>Titanium</td>
<td>2843 BTU/時</td>
<td>50/60Hz</td>
<td>200 ~ 240 V AC、オートレンジ</td>
<td>750 W</td>
<td>750 W</td>
<td>該当なし</td>
<td>5 A</td>
</tr>
<tr>
<td>750 W 混在モードHVDC（中国のみ）</td>
<td>該当なし</td>
<td>2891 BTU/時</td>
<td>該当なし</td>
<td>240 V DC、オートレンジ</td>
<td>該当なし</td>
<td>該当なし</td>
<td>750W</td>
<td>4.5 A</td>
</tr>
<tr>
<td>1100 W AC</td>
<td>Platinum</td>
<td>4100 BTU/時</td>
<td>50/60Hz</td>
<td>100 ~ 240 V AC、オートレンジ</td>
<td>1100 W</td>
<td>1050 W</td>
<td>12 A ~ 6.5 A</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1100 W DC</td>
<td>該当なし</td>
<td>4416 BTU/時</td>
<td>該当なし</td>
<td>– (48–60) V DC、オートレンジ</td>
<td>該当なし</td>
<td>該当なし</td>
<td>1100 W</td>
<td>32 A</td>
</tr>
<tr>
<td>1100 W 混在モードHVDC（中国および日本のみ）</td>
<td>該当なし</td>
<td>4100 BTU/時</td>
<td>該当なし</td>
<td>200 ~ 380 V DC、オートレンジ</td>
<td>該当なし</td>
<td>該当なし</td>
<td>1100 W</td>
<td>6.4 A ~ 3.2 A</td>
</tr>
<tr>
<td>1600 W AC</td>
<td>Platinum</td>
<td>6000 BTU/時</td>
<td>50/60Hz</td>
<td>100 ~ 240 V AC、オートレンジ</td>
<td>1600 W</td>
<td>800 W</td>
<td>該当なし</td>
<td>10 A</td>
</tr>
<tr>
<td>2000 W AC</td>
<td>Platinum</td>
<td>7500 BTU/時</td>
<td>50/60Hz</td>
<td>100 ~ 240 V AC、オートレンジ</td>
<td>2000 W</td>
<td>1000 W</td>
<td>該当なし</td>
<td>11.5 A</td>
</tr>
<tr>
<td>2400 W AC</td>
<td>Platinum</td>
<td>9000 BTU/時</td>
<td>50/60Hz</td>
<td>100 ~ 240 V AC、オートレンジ</td>
<td>2400 W</td>
<td>1400 W</td>
<td>該当なし</td>
<td>16 A</td>
</tr>
</tbody>
</table>

メモ: 熱消費は PSU のワット定格を用いて算出されています。
メモ: このシステムは、線間電圧が 240 V 以下の IT 電力システムに接続できるようにも設計されています。
メモ: 定格 1100 W 混在モードHVDC または 1100 W AC 以上の PSU については、定格容量に合った高圧線電圧 (200 ~ 240 V AC) が必要となります。
システムバッテリーの仕様

PowerEdge R740xd システムは、CR 2032 3.0-V コイン型リチウム電池システムバッテリをサポートします。

拡張バスの仕様

PowerEdge R740xd システムでは、最大 8 枚の PCIe (PCIe express) 第 3 世代拡張カードをサポートします。これらのカードは拡張カードライザーを使用してシステム基板上に取り付けることができます。次の表には、拡張カードライザーの仕様についての詳細が記載されています。

表 4. 拡張カードライザー構成

<table>
<thead>
<tr>
<th>拡張カードライザー</th>
<th>ライザー上のPCIeスロット</th>
<th>高さ</th>
<th>長さ</th>
<th>リンク</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ライザー1A</td>
<td>スロット1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スロット3</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x16</td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー1B</td>
<td>スロット1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スロット2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スロット3</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー1D</td>
<td>スロット1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スロット2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スロット3</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー2A</td>
<td>スロット4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スロット5</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スロット6</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー2B</td>
<td>スロット4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スロット4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x16</td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー2C</td>
<td>スロット4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー3A</td>
<td>スロット7</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スロット8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表 5. 拡張カードライザーの仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>ライザーの構成</th>
<th>スロットの説明</th>
<th>PCIeスロット</th>
<th>ライザー1のPCIeスロット (高さと長さ)</th>
<th>プロセッサの接続</th>
<th>ライザー2のPCIeスロット (高さと長さ)</th>
<th>プロセッサの接続</th>
<th>ライザー3のPCIeスロット (高さと長さ)</th>
<th>プロセッサの接続</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ライザー構成0</td>
<td>PCIeスロット</td>
<td>なし</td>
<td>該当なし</td>
<td>該当なし</td>
<td>該当なし</td>
<td>該当なし</td>
<td>該当なし</td>
<td>該当なし</td>
</tr>
<tr>
<td>(背面ストレージの有無にかかわらない) (ライザーなし)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー構成1</td>
<td>PCIeスロット</td>
<td>(4)および背面ストレージの有無にかかわらない (1B +2B)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー構成2</td>
<td>PCIeスロット</td>
<td>(3)および背面ストレージの有無にかかわる (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ライザーの構成とサポートされるライザー</td>
<td>スロットの説明</td>
<td>ライザー1のPCIeスロット（高さと長さ）</td>
<td>プロセッサの接続</td>
<td>ライザー2のPCIeスロット（高さと長さ）</td>
<td>プロセッサの接続</td>
<td>ライザー3のPCIeスロット（高さと長さ）</td>
<td>プロセッサの接続</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>なし (1B +2C ) よび背面ストレージ</td>
<td>x8スロット (2)およびx16スロット (3)</td>
<td>スロット 2: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 4: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 5: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー構成3 (1A+2A)</td>
<td></td>
<td>スロット 3: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー構成4 (1A+2A+3A)</td>
<td></td>
<td>スロット 1: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 4: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 5: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>スロット 3: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 6: x8 ロープロファイル、ハーフレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー構成5 (1B+2A+3A)</td>
<td></td>
<td>スロット 1: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 4: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 7: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>スロット 2: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 5: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 8: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー構成6 (1D+2A+3A)</td>
<td></td>
<td>スロット 3: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 6: x8 ロープロファイル、ハーフレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>スロット 1: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 4: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 7: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>スロット 2: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 5: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 8: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ライザー構成9 (1A+2D+3A)</td>
<td></td>
<td>スロット 3: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 6: x8 ロープロファイル、ハーフレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>スロット 1: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 1 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 4: x16 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td>スロット 7: x8 フルハイ、フルレングス</td>
<td>Processor 2 (プロセッサ1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

技術仕様
メモリの仕様

表 6. メモリの仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>メモリモジュールソケット</th>
<th>DIMMのタイプ</th>
<th>DIMMのランク</th>
<th>DIMMの容量</th>
<th>シングルプロセッサー</th>
<th>デュアルプロセッサー</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>最小 RAM</td>
<td>最大 RAM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>最小 RAM</td>
<td>最大 RAM</td>
</tr>
<tr>
<td>LRDIMM</td>
<td>オクタランク</td>
<td>128 GB</td>
<td>128 GB</td>
<td>1.5 TB</td>
<td>256 GB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>クアッドランク</td>
<td>64 GB</td>
<td>64 GB</td>
<td>768 GB</td>
<td>128 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>RDIMM</td>
<td>シングルランク</td>
<td>8 GB</td>
<td>8 GB</td>
<td>96 GB</td>
<td>16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デュアルランク</td>
<td>16 GB</td>
<td>16 GB</td>
<td>192 GB</td>
<td>32 GB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デュアルランク</td>
<td>32 GB</td>
<td>32 GB</td>
<td>384 GB</td>
<td>64 GB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デュアルランク</td>
<td>64 GB</td>
<td>64 GB</td>
<td>768 GB</td>
<td>128 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>NVDIMM-N</td>
<td>シングルランク</td>
<td>16 GB</td>
<td>シングルプロセッサーではサポートされていません</td>
<td>シングルプロセッサーではサポートされていません</td>
<td>RDIMM：192 GB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>NVDIMM-N</td>
<td>NVDIMM-N: 16 GB</td>
<td>NVDIMM-N: 192 GB</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>該当なし</td>
<td>256 GB</td>
<td>該当なし</td>
<td>RDIMM: 384 GB</td>
<td>LRDIMM: 1536 GB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>該当なし</td>
<td>512 GB</td>
<td>該当なし</td>
<td>RDIMM: 384 GB</td>
<td>LRDIMM: 1536 GB</td>
</tr>
</tbody>
</table>

メモ：8 GB RDIMM と NVDIMM-N を1つのエンクロージャ内に混在させないでください。

メモ：64 GB LRDIMM と 128 GB LRDIMM を混在させないでください。

メモ：NVDIMM-N をサポートするすべての構成で、最低2つのCPUが必要です。

メモ：DCPMM は、RDIMM および LRDIMM と併用することができます。

メモ：異なるタイプのDDR4 DIMM（RDIMM、LRDIMM）をチャネル内、内蔵メモリコントローラー内、ソケット内、またソケット間で混在させることはできません。

メモ：x4 と x8 のDDR4 DIMM は、チャネル内で混在させることができます。

メモ：インテル データセンターやの永続メモリモジュールの動作モード（App Direct、Memoryモード）を、ソケット内またはソケット間で混在させることはできません。

ストレージコントローラの仕様

PowerEdge R740xd システムは、次をサポートしています。
内蔵ストレージコントローラーカード：PERC (PowerEdge RAID Controller) H330、PERC H730P、PERC H740P、HBA330、S140、BOSS-S1（Boot Optimized Server Storage）

BOSSカードはシンプルなRAIDソリューションカードで、サーバのオペレーティングシステムの起動のために特別に設計されています。このカードは最大2台の6Gbps M.2 SATAドライブをサポートします。BOSSアダプタカードはPCIe Gen 2.0 x2トーンを使用するx8コネクタを備え、ロープロファイルおよびハープライトフォームファクタでのみ使用できます。

外部ストレージコントローラーカード：PERC H840および12Gbps SAS HBA

ドライブの仕様

PowerEdge R740XDシステムは、SAS、SATA、Nearline SASハードドライブ/SSD、またはNVMeドライブをサポートしています。

表7. PowerEdge R740XDシステムでサポートされているドライブオプション

<table>
<thead>
<tr>
<th>構成</th>
<th>説明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12台のドライブシステム</td>
<td>スロット0〜11に最大12台の3.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)前面アクセス可能ドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>14台のドライブシステム</td>
<td>スロット0〜11に最大12台の3.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)前面アクセス可能ドライブ、スロット12〜13に最大2台の3.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)背面アクセス可能ドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>16台のドライブシステム</td>
<td>スロット0〜11に最大12台の3.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)前面アクセス可能ドライブ、スロット12〜15に最大4台の2.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)背面アクセス可能ドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>18台のドライブシステム</td>
<td>スロット0〜11に最大12台の3.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)前面アクセス可能ドライブ、スロット14〜17に最大4台の3.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)ミッドドライブ、スロット12〜13に最大2台の3.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)背面アクセス可能ドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>20台のドライブシステム</td>
<td>スロット0〜11に最大12台の3.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)前面アクセス可能ドライブ、スロット16〜19に最大4台の3.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)ミッドドライブ、スロット12〜15に最大4台の2.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)背面アクセス可能ドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>24台のドライブシステム</td>
<td>スロット0〜23に最大24台の2.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)前面アクセス可能ドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>24台のドライブシステム</td>
<td>スロット0〜11に最大12台の2.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)前面アクセス可能ドライブおよび12個のユニバーサルスロット12〜23に最大12台の2.5インチNVMeドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>24台のドライブシステム</td>
<td>ベイ1(スロット0〜11)とベイ2(スロット0〜11)に最大24台の2.5インチNVMeドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>24台のドライブシステム</td>
<td>ベイ1(スロット0〜7)に最大24台の2.5インチNVMeドライブまたは最大8台の2.5インチ(SASまたはSATA)、その他のスロットにNVMeドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>28台のドライブシステム</td>
<td>スロット0〜23に最大24台の2.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)前面アクセス可能ドライブおよびスロット24〜27に最大4台の2.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)背面アクセス可能ドライブ</td>
</tr>
<tr>
<td>32台のドライブシステム</td>
<td>スロット0〜23に最大24台の2.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)前面アクセス可能ドライブ、スロット28〜31に最大4台の2.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)ミッドドライブ、スロット24〜27に最大4台の2.5インチ(SAS、SATAまたはNearline SAS)背面アクセス可能ドライブ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

memo:ユニバーサルスロットは、SAS、SATAハードドライブ/SSD、またはNVMeドライブと同じスロットでサポートするスロットです。

技術仕様 11
ポートおよびコネクタの仕様

USB ポート
PowerEdge R740xd システムは、次をサポートしています。
- システム前面の USB 2.0 対応ポート (2)
- 内蔵 USB 3.0 対応ポート (1)
- システム前面のマイクロ USB 2.0 対応ポート (1) (iDRAC ダイレクト用)
- システム背面の USB 3.0 対応ポート (2)

NIC ポート
PowerEdge R740xd システムは、NDC (ネットワーク ドーター カード) に内蔵されている最大 4 個の NIC (ネットワーク インターフェイス コントローラ) ポートをサポートしており、次の構成で使用可能です。
- 10、100、1000 Mbps をサポートする RJ-45 ポート (4)
- 100 M、1G、10 Gbps をサポートする RJ-45 ポート (4)
- RJ-45 ポート (4)。うち 2 個のポートは最大 10 G、他の 2 個のポートは最大 1 G をサポート
- 最大 1 Gbps をサポートする RJ-45 ポート (2) および最大 10 Gbps をサポートする 2 SFP+ ポート
- 最大 10 Gbps をサポートする SFP+ ポート (4)
- 最大 25 Gbps をサポートする SFP28 ポート (2)

メモ: 最大 8 枚の PCIe アドオン NIC カードを取り付けることができます。

VGA ポート
VGA (ビデオ グラフィック アレイ) ポートを使用して、システムを VGA ディスプレイに接続することができます。PowerEdge R740xd システムは、前面および背面パネルの 15 ビン VGA ポートを 2 個サポートしています。

シリアルコネクタ
PowerEdge R740xd システムは、背面パネルでシリアル コネクタ 1 個をサポートしており、このコネクタは、9 ビン コネクタ、DTE (データ端末装置) 、16550 準拠です。

内蔵デュアル SD モジュールまたは vFlash カード
PowerEdge R740xd システムは、IDSDM (内蔵デュアル SD モジュール) と vFlash カードをサポートします。第 14 世代の PowerEdge サーバでは、IDSDM と vFlash カードは 1 枚のカード モジュールに組み合わされており、次の構成で使用可能です。
- vFlash または
- IDSDM または
- vFlash と IDSDM

IDSDM/vFlash カードはシステムの背面のデル独自のスロットにあります。IDSDM/vFlash カードは 3 枚の micro SD カードをサポートします (IDSDM 用に 2 枚のカード、vFlash 用に 1 枚のカード)。IDSDM 用 micro SD カードの容量は 16/32/64 GB で、vFlash 用 micro SD カードの容量は 16 GB です。

ビデオの仕様
PowerEdge R740xd システムは、16 MB のビデオ フレーム パッファ搭載の内蔵 Matrox G200eW3 グラフィックス コントローラをサポートしています。
表 8. サポートされているビデオ解像度のオプション

<table>
<thead>
<tr>
<th>解像度</th>
<th>リフレッシュレート（Hz）</th>
<th>色深度（ビット）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1024 x 768</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
<tr>
<td>1280 x 800</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
<tr>
<td>1280 x 1024</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
<tr>
<td>1360 x 768</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
<tr>
<td>1440 x 900</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
<tr>
<td>1600 x 900</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
<tr>
<td>1600 x 1200</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
<tr>
<td>1680 x 1050</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
<tr>
<td>1920 x 1080</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
<tr>
<td>1920 x 1200</td>
<td>60</td>
<td>8, 16, 32</td>
</tr>
</tbody>
</table>

メモ: 1920 x 1080 および 1920 x 1200 の解像度は、リデュースド ブランディング モードでのみサポートされます。

環境仕様

メモ: 環境認定の詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals の「マニュアルおよび文書」にある「製品環境データシート」を参照してください。

表 9. 温度の仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>温度</th>
<th>仕様</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ストレージ</td>
<td>-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)</td>
</tr>
<tr>
<td>継続動作（高度 950 m（3177 フィート）未満）</td>
<td>10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)、装置への直射日光なし。</td>
</tr>
<tr>
<td>最大温度勾配（動作時および保管時）</td>
<td>20°C/h (68°F/h)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表 10. 相対湿度の仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>相対湿度</th>
<th>仕様</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ストレージ</td>
<td>最大露点 33°C (91°F) で相対湿度 5% 〜 95%。空気は常に非結露状態である必要があります。</td>
</tr>
<tr>
<td>動作時</td>
<td>最大露点 29°C (84.2°F) で 10% 〜 80% の相対湿度。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表 11. 最大振動の仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>最大耐久振動度</th>
<th>仕様</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>動作時</td>
<td>0.26 G_{rms} (5 〜 350 Hz) （全稼働方向）。</td>
</tr>
<tr>
<td>ストレージ</td>
<td>1.88 G_{rms} (10 〜 500 Hz) で 15 分間（全 6 面で検証済）。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表 12. 最大衝撃の仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>最大耐久衝撃</th>
<th>仕様</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>動作時</td>
<td>x, y, z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス、11 ミリ秒以下で 6 G。</td>
</tr>
<tr>
<td>ストレージ</td>
<td>x, y, z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス（システムの各面に対して 1 パルス）、2 ミリ秒以下で 71 G。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 表 13. 最大高度の仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>最大高度</th>
<th>仕様</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>動作時</td>
<td>3048 m (10,000 ft)</td>
</tr>
<tr>
<td>ストレージ</td>
<td>12,000 m (39,370 フィート)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 表 14. 動作時温度ディレーティングの仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>動作時温度ディレーティング</th>
<th>仕様</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>最高 35℃ (95°F)</td>
<td>950 m (3117 フィート)を越える高度では、最高温度は300 m (547 フィート) ごとに1℃ (1°F) 低くなります。</td>
</tr>
<tr>
<td>35～40℃ (95～104°F)</td>
<td>950 m (3117 フィート)を越える高度では、最高温度は175 m (319 フィート) ごとに1℃ (1°F) 低くなります。</td>
</tr>
<tr>
<td>40～45℃ (104～113°F)</td>
<td>950 m (3117 フィート)を越える高度では、最高温度は125 m (228 フィート) ごとに1℃ (1°F) 低くなります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 標準動作温度

### 表 15. 動作時の標準温度の仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>標準動作温度</th>
<th>仕様</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>継続動作 (高度 950 m (3117 フィート)未満)</td>
<td>10℃～35℃ (50°F～95°F)、装置への直射日光なし。</td>
</tr>
<tr>
<td>相対湿度範囲</td>
<td>最大露点 29℃ (84.2°F)で 10～80% の相対湿度。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 動作時の拡張温度

### 表 16. 動作時の拡張温度の仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th>動作時の拡張温度</th>
<th>仕様</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 継続動作        | 相対湿度 5～85%、露点温度 29℃ (84.2°F)で、5～40℃。

1. メモ: 標準動作温度 (10～35℃) の範囲外では、下は 5℃ まで、上は 40℃ までで、システムは継続的に動作できます。

35～40℃ の場合、950 m を越える場所では 175 m (319 フィート) 上昇するごとに最大許容温度を 1℃ (1°F) 下げます。

年間動作時間の 1 パーセント以下  | 相対湿度 5～90 パーセント、露点温度 29℃ で、−5～45℃。

1. メモ: 標準動作温度範囲 (10～35℃) 外で使用する場合は、最大年間動作時間の最大 1% まで−5～45℃ の範囲で作動することができます。

40～45℃ の場合、950 m を越える場所では 125 m (228 フィート) 上昇するごとに最大許容温度を 1℃ (1°F) 下げます。 |

1. メモ: 動作時の拡張温度範囲で使用すると、システムのパフォーマンスに影響が生じる場合があります。

1. メモ: 拡張温度範囲でシステムを使用している際に、システムイベントログに周囲温度の警告が報告される場合があります。

### 動作時の拡張温度範囲に関する制限

- 128 GB の LRDIMM は FAC に対応していません。
- 5℃ 未満でクールドプートを行わないでください。
- 動作温度は最大高度 3050 m (10,000 フィート) を想定しています。
- 150 W/8 コア、165 W/12 コア、およびそれ以上のワット数のプロセッサー [ 熱設計電力 (TDP) >165 W] はサポートされていません。
- 冗長電源ユニットが必要です。
デル認定外の周辺機器カードおよび/または25 Wを超える周辺機器カードは非対応です。
PCIe SSDは非対応です。
NVDIMM-Nはサポートされません。
DCPMMはサポートされません。
ミッドドライブトレイはサポートされません。
背面ストレージデバイスまたはドライブはサポートされません。
GPUは非対応です。
テープバックアップユニットはサポートされません。

温度制限
次の表には効率的な冷却に必要な構成を示しています。

表17. 温度制限の構成

<table>
<thead>
<tr>
<th>構成</th>
<th>プロセッサ数</th>
<th>ヒートシンク</th>
<th>プロセッサ/DIMMダミー</th>
<th>DIMMのダミー</th>
<th>エアフローカバーのタイプ</th>
<th>ファンタイプ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PowerEdge R740xd</td>
<td>1</td>
<td>CPU ≤ 125 W用の1U標準ヒートシンク (1)</td>
<td>必須</td>
<td>不要</td>
<td>標準</td>
<td>標準ファン (4)、ダミー (1) (2つのファンスロットのカバー用)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
<td>CPU &gt; 125 W用の2U標準ヒートシンク (1)</td>
<td>不要</td>
<td>不要</td>
<td>標準</td>
<td>標準ファン (6)</td>
</tr>
<tr>
<td>PowerEdge R740xd</td>
<td>1</td>
<td>1Uハイパフォーマンスヒートシンク (1)</td>
<td>必須</td>
<td>不要</td>
<td>ハイパフォーマンスファン (6)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
<td>1Uハイパフォーマンスヒートシンク (2)</td>
<td>必須</td>
<td>不要</td>
<td>ハイパフォーマンスファン (6)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PowerEdge R740xd</td>
<td>2</td>
<td>1Uハイパフォーマンスヒートシンク (1)</td>
<td>必須</td>
<td>不要</td>
<td>ハイパフォーマンスファン (6)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
<td>1Uハイパフォーマンスヒートシンク (2)</td>
<td>不要</td>
<td>GPUエアフローカバー</td>
<td>ハイパフォーマンスファン (6)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PowerEdge R740xd</td>
<td>1</td>
<td>CPU ≤ 125 W用の1U標準ヒートシンク (1)</td>
<td>必須</td>
<td>不要</td>
<td>ハイパフォーマンスファン (6)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
<td>CPU &gt; 125 W用の2U標準ヒートシンク (1)</td>
<td>不要</td>
<td>不要</td>
<td>標準</td>
<td>標準ファン (6)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

周囲温度の制限
次の表は、周囲温度35℃未満を要件とする構成を示しています。

1. メモ: 適切な冷却を確保し、CPUの過度なスロットルを避けるため、周囲温度の制限は守ってください。システムパフォーマンスに影響を与える場合があります。
粒子状およびガス状汚染物質の仕様

次の表は、粒子状およびガス状の汚染物質による機器の損傷、または故障を回避するために役立つ制限を定義しています。粒子状またはガス状の汚染物質のレベルが指定された制限を超え、その結果として機器が損傷または故障した場合は、環境条件の是正が必要になる可能性があります。環境条件の改善はお客様の責任となります。環境状態の改善は、お客様の責任となります。

表18. 構成ごとの周囲温度の制限

<table>
<thead>
<tr>
<th>システム</th>
<th>バックプレーン</th>
<th>プロセッサーの熱設計電力 (TDP)</th>
<th>プロセッサーヒートシンク</th>
<th>サーマル</th>
<th>GPU</th>
<th>周囲温度制限</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PowerEdge R740xd</td>
<td>12 x 3.5 インチ SAS/SATA + 4 x 3.5 インチ</td>
<td>150 W/8 コア、165 W/12 コア、200 W、205 W</td>
<td>1U ハイパフォーマンスファン</td>
<td>すべて</td>
<td>V100 32 GB</td>
<td>25℃</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24 x 2.5 インチ SAS/SATA + 4 x 2.5 インチ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30℃</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24 x NVMe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30℃</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22 x NVMe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>25℃</td>
</tr>
</tbody>
</table>

粒子状およびガス状汚染物質の仕様

次の表は、粒子状およびガス状の汚染物質による機器の損傷、または故障を回避するために役立つ制限を定義しています。粒子状またはガス状の汚染物質のレベルが指定された制限を超え、その結果として機器が損傷または故障した場合は、環境条件の是正が必要になる可能性があります。環境条件の改善はお客様の責任となります。環境状態の改善は、お客様の責任となります。

表19. 粒子状汚染物質の仕様

粒子汚染 | 仕様
--- | ---
空気清浄 | データセンターの空気清浄レベルは、ISO 14644-1のISOクラス8の定義に準じ、95%上限値が限界です。
| メモ: ISOクラス8の条件は、データセンター環境のみに適用されます。空気清浄要件は、事務所や工場現場などのデータセンター外での使用のために設計されたIT装置には適用されません。
| メモ: データセンターニュース空気は、MERV11またはMERV13フィルタで通過する必要があります。

伝導性ダスト | 空気中に伝導性ダスト、亜鉛ウィスカ、またはその他の伝導性粒子が存在しないようにする必要があります。
| メモ: この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。

腐食性ダスト | 空気中に腐食性ダストが存在しないようにする必要があります。
| 空気中の残留ダストは、潮解点が相対湿度60%未満である必要があります。
| メモ: この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。

表20. ガス状汚染物質の仕様

ガス状汚染物質 | 仕様
--- | ---
銅銅粉酸度 | クラスG1(ANSI/ISA71.04-2013の定義による)に準じ、ひと月あたり300 ppm未満。
| メモ: 50%以下と相対湿度で測定された最大腐食汚染レベル

銀銅粉酸度 | ANSI/ISA71.04-2013の定義に準じ、ひと月あたり200 ppm未満。
マニュアルリソース

本項では、お使いのシステムのマニュアルリソースに関する情報を提供します。
マニュアルリソースの表に記載されているマニュアルを参照するには、次の手順を実行します。

- Dell EMC サポートサイトにアクセスします。
  1. 表の「場所」列に記載されているマニュアルのリンクをクリックします。
  2. 目的の製品または製品バージョンをクリックします。

  製品名とモデルを確認する場合は、お使いのシステムの前面を調べてください。
  3. [製品サポート] ページで、[マニュアルおよび文書] をクリックします。
- 検索エンジンを使用します。
- 検索ボックスに名前および文書のバージョンを入力します。

### 表 21. お使いのシステムのためのその他マニュアルのリソース

<table>
<thead>
<tr>
<th>タスク</th>
<th>文書</th>
<th>場所</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>システムのセットアップ</td>
<td>システムをラックに取り付けて固定する方法の詳細については、お使いのラック ソリューションに同梱の『レール取り付けガイド』を参照してください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/poweredgemanuals">www.dell.com/poweredgemanuals</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>お使いのシステムのセットアップの詳細については、システムに同梱の『はじめに』マニュアルを参照してください。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>RACADM（Remote Access Controller Admin）サブコマンドとサポートされている RACADM インターフェイスを理解するための情報については、「RACADM CLI Guide for IDRAC」を参照してください。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Redfish およびそのプロトコル、サポートされているスキャマおよび一部を実装されている Redfish Eventing の詳細については、「Redfish API Guide」を参照してください。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IDRAC プロパティ データベース グループとオブジェクトの記述の詳細については、「Attribute Registry Guide」を参照してください。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>旧バージョンの IDRAC のマニュアルについて</td>
<td>旧バージョンの IDRAC のマニュアルについては、右記の URL にアクセスしてください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/idracmanuals">www.dell.com/idracmanuals</a></td>
</tr>
<tr>
<td>お使いのシステムで使用可能な IDRAC のバージョンを特定するには、IDRAC Web インターフェイスで [?]、[About] の順にクリックします。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>タスク</td>
<td>文書</td>
<td>場所</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>ドライバおよびファームウェアのアップデートについての情報は、本書の「ファームウェアとドライバをダウンロードする方法」の項を参照してください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/support/drivers">www.dell.com/support/drivers</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>システムの管理</td>
<td>デルが提供するシステム管理ソフトウェアについての情報は、「Dell OpenManage Systems Management Overview Guide」（Dell OpenManage Systems Management 概要ガイド）を参照してください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/poweredgemanuals">www.dell.com/poweredgemanuals</a></td>
</tr>
<tr>
<td>OpenManage のセットアップ、使用、およびトラブルシューティングについての情報は、「Dell OpenManage Server Administrator User’s Guide」（Dell OpenManage Server Administrator ユーザーズガイド）を参照してください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/openmanagemanuals">www.dell.com/openmanagemanuals</a> &gt; OpenManage Server Administrator</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dell OpenManage Essentials のインストール、使用、およびトラブルシューティングについての情報は、「Dell OpenManage Essentials User’s Guide」（Dell OpenManage Essentials ユーザーズガイド）を参照してください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/openmanagemanuals">www.dell.com/openmanagemanuals</a> &gt; OpenManage Essentials</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>パートナープログラムのエンタープライズシステム管理についての情報は、OpenManage Connections Enterprise Systems Management マニュアルを参照してください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/openmanagemanuals">www.dell.com/openmanagemanuals</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dell PowerEdge RAID コントローラの操作</td>
<td>Dell PowerEdge RAID コントローラ（PERC）、ソフトウェア RAID コントローラ、BOSS カードの機能を把握するための情報や、カードの導入に関する情報については、ストレージコントローラのマニュアルを参照してください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/storagecontrollermanuals">www.dell.com/storagecontrollermanuals</a></td>
</tr>
<tr>
<td>イベントおよびエラーメッセージの理解</td>
<td>システムファームウェア、およびシステムコンポーネントを監視するエージェントによって生成されたイベントメッセージおよびエラーメッセージの情報については、「Error Code Lookup」を参照してください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/qrl">www.dell.com/qrl</a></td>
</tr>
<tr>
<td>システムのトラブルシューティング</td>
<td>PowerEdge サーバーの問題を特定してトラブルシューティングを行うための情報については、「Server Troubleshooting Guide」（サーバートラブルシューティングガイド）を参照してください。</td>
<td><a href="http://www.dell.com/poweredgemanuals">www.dell.com/poweredgemanuals</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
困ったときは

トピック：
- Dell EMC へのお問い合わせ
- マニュアルのフィードバック
- QRL によるシステム情報へのアクセス
- SupportAssist による自動サポートの利用
- リサイクルまたはサービス終了の情報

Dell EMC へのお問い合わせ

Dell EMC では、オンラインおよび電話によるサポートとサービスオプションをいくつかご用意しています。お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または Dell EMC 製品カタログで連絡先をご確認ください。これらのサービスは国および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があります。Dell EMC のセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスは、次の手順でお問い合わせいただけます。

手順
1. www.dell.com/support/home にアクセスします。
2. お住まいの国を、ページ右下隅のドロップダウンメニューから選択します。
3. カスタマイズされたサポートを利用するには、次の手順に従います。
   a) Enter your Service Tag（サービスタグの入力）フィールドに、お使いのシステムのサービスタグを入力します。
   b) 送信をクリックします。
   さまざまなサポートのカテゴリをリストアップしているサポートページが表示されます。
4. 一般的なサポートを利用するには、次の手順に従います。
   a) 製品カテゴリを選択します。
   b) 製品セグメントを選択します。
   c) お使いの製品を選択します。
   さまざまなサポートのカテゴリをリストアップしているサポートページが表示されます。
5. Dell EMC グローバル テクニカルサポートへのお問い合わせ先の詳細については、次の手順に従います。
   a) グローバルテクニカルサポートをクリックします。
   b) [テクニカルサポートへのお問い合わせ] ページには、Dell EMC グローバル テクニカルサポートチームへの電話、チャット、または電子メール送信のための詳細が記載されています。

マニュアルのフィードバック

任意の Dell EMC マニュアルページでマニュアルを評価、またはフィードバックを書き、[フィードバックの送信] をクリックしてフィードバックを送信することができます。

QRL によるシステム情報へのアクセス

R740xd の前面にある情報タグに記載されている Quick Resource Locator (QRL) を使用して、Dell EMC PowerEdge の R740xd に関する情報にアクセスできます。

前提条件
お使いのスマートフォンまたはタブレットに QRL コードスキャナがインストールされていることを確認します。
QRL には、お使いのシステムに関する次の情報が含まれています。
- ハウツービデオ
インストールおよびサービス マニュアル、LCD Diagnostics（診断）、機械的概要などの参照資料
特定のハードウェア構成および保証情報に簡単にアクセスするためのシステムのサービススタグ
テクニカルサポートや営業チームへのお問い合わせのためのデルへの直接的なリンク

手順
1. www.dell.com/qrl にアクセスして、お使いの製品に移動する、または
2. システム上、または「クイックリソースロケータ」セクションで、お使いのスマートフォンまたはタブレットを使用してモデル固有のクイックリソース（QR）コードをスキャンします。

PowerEdge R740 システム用 Quick Resource Locator

図 2. PowerEdge R740 システム用 Quick Resource Locator

SupportAssist による自動サポートの利用

Dell EMC SupportAssist は、Dell EMC のサーバ、ストレージ、ネットワーキング デバイスのテクニカルサポートを自動化するオプションの Dell EMC Services です。SupportAssist アプリケーションをインストールしてご利用の IT 環境にセットアップすると、次のようなメリットがあります。

• 自動課題検知 — SupportAssist により、ご利用の Dell EMC デバイスを監視し、プロアクティブかつ予測的にハードウェアの課題を自動検知します。
• ケースの自動作成 — 課題が検知されると、SupportAssist によって Dell EMC テクニカルサポートへのサポートケースが自動的に作成されます。
• 自動診断収集 — SupportAssist により、ご利用のデバイスからシステム状態に関する情報を自動的に収集し、Dell EMC に安全にアップロードします。この情報は、Dell EMC テクニカルサポートによる、課題のトラブルシューティングに使用されます。
• プロアクティブな連絡 — Dell EMC テクニカルサポートエージェントがサポートケースについて連絡し、課題を解決するお手伝いをします。

使用可能なサービスは、お使いのデバイス用に購入した Dell EMC Service の利用資格に応じて異なります。SupportAssist の詳細については、www.dell.com/supportassist を参照してください。

リサイクルまたはサービス終了の情報

特定の国では、この製品の引き取りおよびリサイクルサービスが提供されます。システムコンポーネントを廃棄する場合は、www.dell.com/recyclingworldwide にアクセスし、該当する国を選択します。